

# 日月光九十一年度第四季及全年業績簡訊

日月光於台灣時間 92 年 2 月 18 日同步於美國及台灣兩地發佈九十一年度第四季及全年獲利報告，因半導體產業景氣已逐漸復甦，本公司第四季單季之營業收入較今年第三季成長 8%，亦較去年同期大幅成長 25%，為新台幣 12,854 百萬元，另如不考慮第四季提列之資產價值損失新台幣 1,226 百萬元，則獲利狀況不論與去年同期或上一季比較，皆已明顯提昇。茲將日月光第四季單季之營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

表(一)日月光第四季簡明營運成果分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	91 年度 第四季		91 年度 第三季	90 年度 第四季	91 年度 全年累計		90 年度 全年累計
	含提列資產價值 損失	不含提列資產價 值損失			含提列資產價值 損失	不含提列資產價 值損失	
營業收入	12,854	12,854	11,861	10,255	45,587	45,587	38,368
營業毛利	2,322	2,322	1,885	1,437	7,095	7,095	5,411
營業利益	(709)	517	222	(139)	(685)	540	(462)
稅前純益	(1,490)	(264)	(270)	(1,512)	(2,756)	(1,530)	(3,178)
稅後純益	(29)	590	315	(1,198)	129	748	(2,142)
稅後 EPS(元)	(0.01)	0.19	0.10	(0.37)	0.04	0.24	(0.66)

表(二)整體業務之產品結構及客戶組成

產 品 項 目	占營收比率(%)
通訊產品	38
汽車及消費性電子產品	25
個人電腦	35
其他	2
前十大客戶佔營收比重	59
IDM 客戶佔營收比重	57

表(三)銷售地區分析

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	54
歐洲	7
台灣	27
日本	1
亞洲其他地區	11

表(四)封裝業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
BGA, Flip Chip	57
QFP, TQFP, LQFP	23
PDIP, PLCC, SOs	9
Others	11
封裝資本支出金額	66 百萬美元
第四季打線機台數	4,393

表(五)測試業務

產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	83
晶圓測試	12
前段測試	5
測試資本支出金額	30 百萬美元
第四季測試機台數	1,066

日月光公司董事長張虔生表示：“對於2002年日月光公司的表現，我們感到十分滿意。儘管全球景氣仍然沒有見到明顯的好轉，但我們仍然達成我們對股東的允諾，營收及獲利均逐季改善。由於我們持續在研發及高階封裝與測試產能的投資，使我們能夠掌握住目前的主流需求。全球IC封測的產能仍有些供過於求，但我們也見到在高階打線製程、覆晶封裝等業務持續成長，而日月光所投入的資本支出正是為了滿足這部份的需求。當有些同業受限於景氣及財務的困境而無法進行必要的投資時，日月光正可以利用此一機會擴大市佔率，特別是在針對IDM客戶方面，會有明顯的成長。”

張虔生董事長為日月光未來的成長下了一個很好的註解：“除了藉由領先地位擴張我們的市場佔有率外，我們更承諾今年將提高我們的獲利。IC封裝測試業務已經到了另一個產業革新的階段，主要的關鍵性差異點不在於價格，而在於服務品質、先進技術能力及產能多寡等決戰因素。而這些因素也將成為日月光與其他競爭者未來最大不同的核心能力所在。”